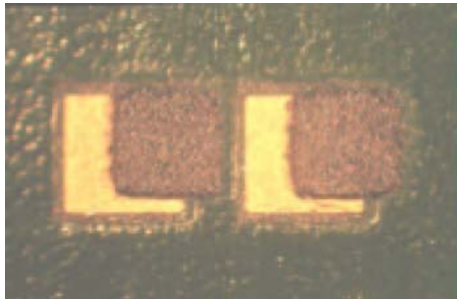
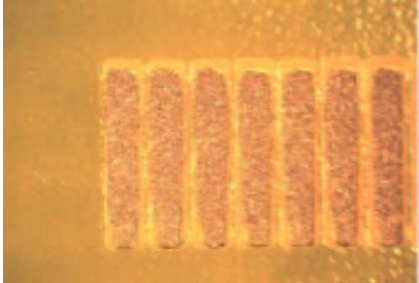
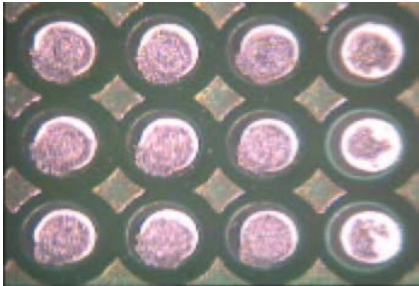
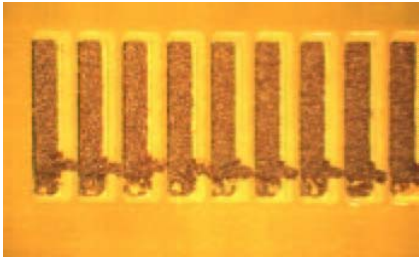
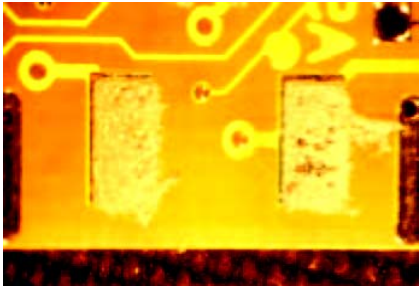


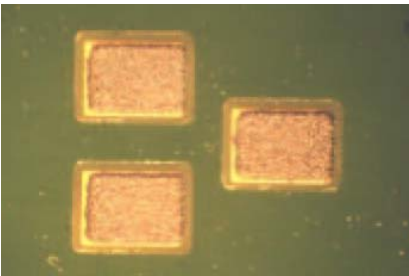
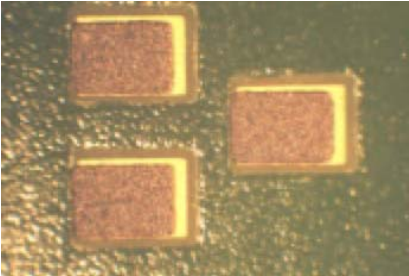
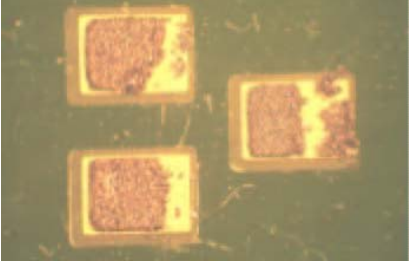
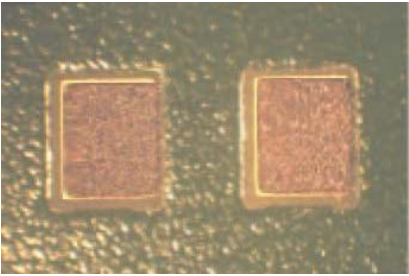
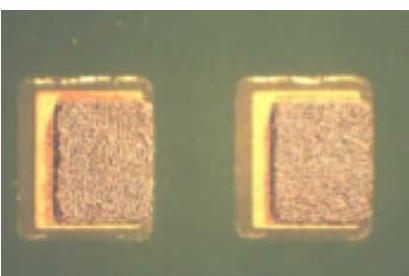
SMT 工艺标准

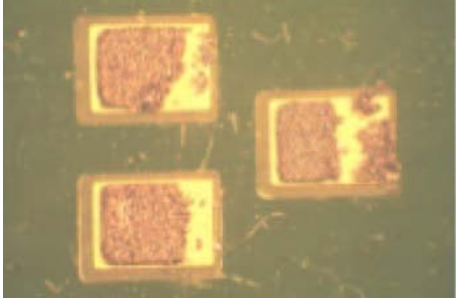
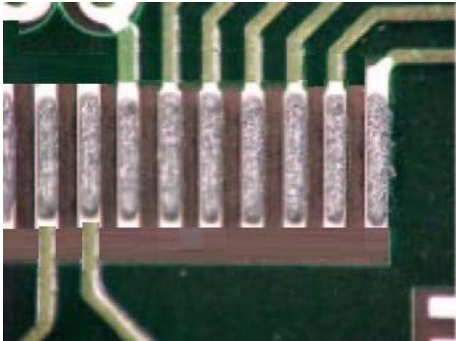
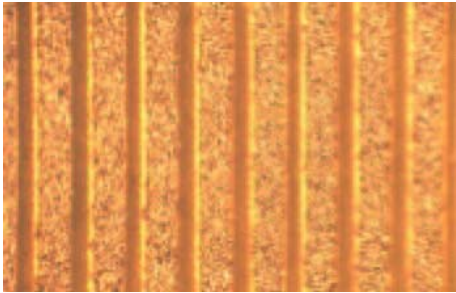
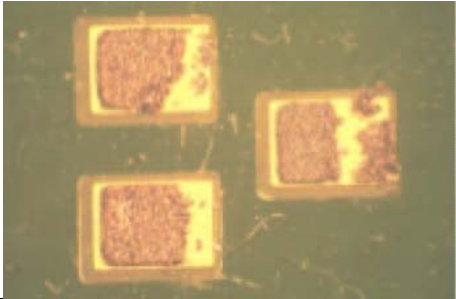
第 1 页 共 5 页

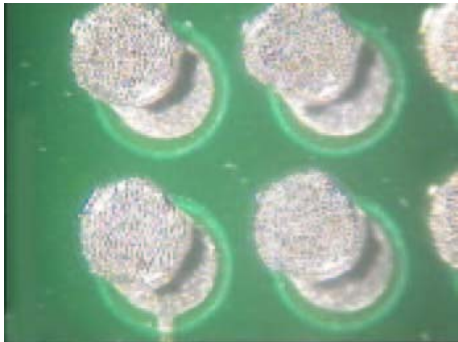
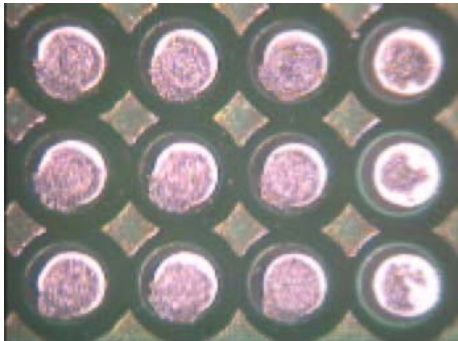
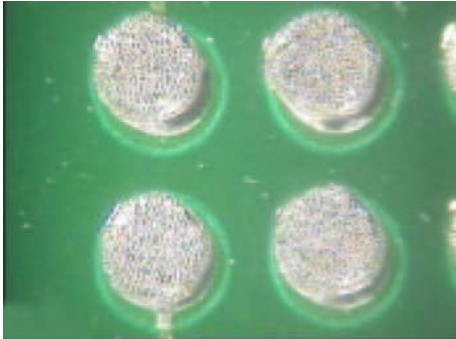
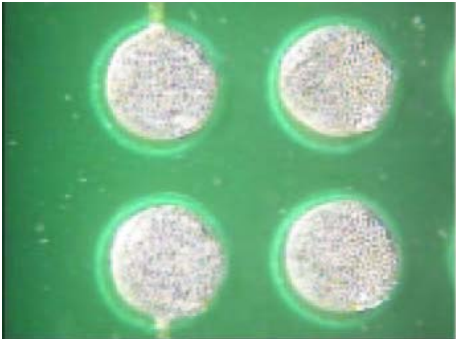
适用机型	手机通用	编号		版次	V1.0															
1.0 目的 制定生产手机贴片板的SMT焊膏印刷工艺标准. 作为生产和检查中判定锡膏印刷板外观是否符合品质要求的依据。 2.0 范围 除有特别规定外, 适用于内部所有产品。 3.0 检验条件和使用工具 3.1 检验条件 对某些印制电路板组件进行目视检查时，如需要可使用放大装置协助观测。 放大装置的公差为所选用放大倍数的±15% ，所选用放大装置须与被测要求项相匹配。用于检查焊接互连情况的放大倍数应根据被测件的最小焊盘宽度来确定。 采用放大倍数如表 3-1 所述。 <table><tr><th>焊盘宽度或焊盘直径</th><th>用于检测放大倍数</th><th>用于仲裁放大倍数</th></tr><tr><td>>1.0 mm （0.039 in）</td><td>1.75X</td><td>4X</td></tr><tr><td>>0.5 至 1.0 mm （0.020~0.039 in）</td><td>4X</td><td>10X</td></tr><tr><td>0.25 至 0.5 mm （0.00984~0.020 in）</td><td>10X</td><td>20X</td></tr><tr><td><0.25 mm （0.00984 in）</td><td>20X</td><td>40X</td></tr></table> 3.2 检验使用工具 防静电手腕带和手套在检验过程中必须佩带。 4. 检查标准 4.1 锡膏印刷缺陷 4.1.1 偏移 焊盘上的焊膏与焊盘未重合，且横向或纵向错位超出焊盘25%以上。 						焊盘宽度或焊盘直径	用于检测放大倍数	用于仲裁放大倍数	>1.0 mm （0.039 in）	1.75X	4X	>0.5 至 1.0 mm （0.020~0.039 in）	4X	10X	0.25 至 0.5 mm （0.00984~0.020 in）	10X	20X	<0.25 mm （0.00984 in）	20X	40X
焊盘宽度或焊盘直径	用于检测放大倍数	用于仲裁放大倍数																		
>1.0 mm （0.039 in）	1.75X	4X																		
>0.5 至 1.0 mm （0.020~0.039 in）	4X	10X																		
0.25 至 0.5 mm （0.00984~0.020 in）	10X	20X																		
<0.25 mm （0.00984 in）	20X	40X																		
拟制		审核		批准																
日期		日期		日期																

版次: V1.0

适用机型	手机通用	编号		版次	V1.0
4.1.2 拉尖 印刷在焊盘上的锡膏表面不平整，有高有低。					
4.1.3 坍塌 印刷在焊盘上的锡膏塌落。					
					
4.1.4 少锡 印刷在焊盘上的锡膏面积少于钢网或焊盘面积的75%。					
					
4.1.5 连锡 相邻两焊盘上的锡膏连在一起。					
					
4.1.6 沾污 锡膏印刷在焊盘以外的区域。					
					
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	

适用机型	手机通用	编号		版次	V1.0
4.2 焊膏印刷检查标准: 4.2.1 SOT 锡膏印刷检查标准 <u>要求:</u> 锡膏表面平整无拉尖, 形状符合钢网或焊盘开口尺寸, 印刷在焊盘上的锡膏应边缘整齐, 无错位, 覆盖焊盘面积75%以上, 位于焊盘表面的正中。 <u>合格</u> 75%以上的锡膏位于焊盘上, 偏移小于0.2mm。 <u>缺陷</u> 焊盘上的锡膏小于焊盘面积或钢网开口面积的75%, 取其中较小者。偏移大于0.2mm。 4.2.2 CHIP 元件印刷检查标准 <u>要求:</u> 锡膏表面平整无拉尖, 形状符合钢网或焊盘开口尺寸, 印刷在焊盘上的锡膏应边缘整齐, 无错位, 覆盖焊盘面积75%以上, 位于焊盘表面的正中。 <u>合格:</u> 75%以上的锡膏位于焊盘上, 偏移小于0.2mm。					
				    	
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	

适用机型	手机通用	编号		版次	V1.0
<u>缺陷</u> 焊盘上的锡膏小于焊盘面积或钢网开口面积的75%，取其中较小者。 偏移大于0.2mm。 					
4.2.3 细间距元件印刷检查标准 <u>要求:</u> 锡膏表面平整无拉尖，形状附和钢网或焊盘开口尺寸，印刷在焊盘上的锡膏应边缘整齐，无错位，覆盖焊盘面积75%以上，位于焊盘表面的正中。 					
<u>合格:</u> 75%以上的锡膏位于焊盘上，错位小于0.1mm。 					
<u>缺陷</u> 焊盘上的锡膏小于焊盘面积或钢网开口面积的75%，取其中较小者。 错位大于0.1mm。 					
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	

适用机型	手机通用	编号		版次	V1.0
4.2.4 BGA/CSP印刷检查标准 要求: 锡膏表面平整无拉尖，形状符合钢网或焊盘开口尺寸，印刷在焊盘上的锡膏应边缘整齐，无错位，覆盖焊盘面积75%以上，位于焊盘表面的正中。 合格 偏移或漏少锡少于25%,偏移小于0.1mm。 缺陷 焊盘上的锡膏小于焊盘面积或钢网开口面积的75%，取其中较小者。 偏移大于0.1mm。 					
拟制		审核		批准	
日期		日期		日期	